

2021-2027年中国半导体封 测市场运行态势及投资策略建议报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2021-2027年中国半导体封测市场运行态势及投资策略建议报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/tongxun/Q36189QOLG.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

半导体生产流程由晶圆制造、晶圆测试、芯片封装和封装后测试组成。半导体封测是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。2017年全球半导体行业收入4204亿美元，封测行业收入533亿美元，占比13%。Yole数据显示，除2014年行业激增导致2015年数据略降外，全球封测行业一直保持个位数稳步增长，预计2019年将继续保持4.5%同比增长。全球封测行业市场规模预测（亿美元）智研数据研究中心发布的《2021-2027年中国半导体封测市场运行态势及投资策略建议报告》共五章。首先介绍了中国半导体封测行业市场发展环境、半导体封测整体运行态势等，接着分析了中国半导体封测行业市场运行的现状，然后介绍了半导体封测市场竞争格局。随后，报告对半导体封测做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国半导体封测行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体封测产业有个系统的了解或者想投资中国半导体封测行业，本报告是您不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 国际半导体产业

1.1 国际半导体产业概况

1.2 IC设计产业

1.3 IC封测产业概况

1.4 中国IC市场

第二章 半导体产业格局

2.1 模拟半导体

2.2 MCU

2.3 DRAM内存产业

2.3.1 DRAM内存产业现状

2.3.2 DRAM内存厂家市场占有率

2.3.3 移动DRAM内存厂家市场占有率

2.4 NAND闪存

2.5 复合半导体产业

第三章 IC制造产业

3.1 IC制造产能

3.2 晶圆代工

3.3 MEMS代工

3.4 中国晶圆代工产业

3.5 晶圆代工市场

3.5.1 国际手机市场规模

3.5.2 手机品牌市场占有率

3.5.3 智能手机市场与产业

3.5.4 PC市场

3.6 IC制造与封测设备市场

3.7 半导体材料市场

第四章 封测所属市场与产业

4.1 封测市场规模 测封行业是中国半导体赶超全球的发力点。中国半导体行业协会（CSIA）统计，2017年中国集成电路产业总销售额5411亿元，其中封测行业1889.7亿元，占比35%，同比增长20.8%，远超同期4.5%的国际增长速度。预计2019年将达2251亿元，同比增长19.1%。

.中国封测行业市场规模预测（亿元）

4.2 封测产业格局

4.3 WLCSP市场

4.4 TSV封装

4.5 半导体测试

4.5.1 Teradyne

4.5.2 Advantest

4.6 国际封测厂家排名

第五章封测厂家研究

5.1 日月光

5.2 Amkor

5.3 硅品精密

- 5.4 星科金朋
- 5.5 力成
- 5.6 超丰
- 5.7 南茂科技
- 5.8 京元电子
- 5.9 Unisem
- 5.10 福懋科技
- 5.11 江苏长电科技
- 5.12 UTAC
- 5.13 菱生精密
- 5.14 南通富士通微电子
- 5.15 华东科技
- 5.16 颀邦科技
- 5.17 J-DEVICES
- 5.18 MPI
- 5.19 STS Semiconductor
- 5.20 Signetics
- 5.21 Hana MiCROn
- 5.22 Nepes
- 5.23 天水华天科技
- 5.24 Shinko

图表目录

- 图表 2015-2019年国际半导体封装材料厂家收入
- 图表 2015-2019年中国IC市场规模
- 图表 2015-2019年中国IC市场产品分布
- 图表 2015-2019年中国IC市场下游应用分布
- 图表 2015-2019年中国IC市场主要厂家市场占有率
- 图表 2015-2019年模拟半导体主要厂家市场占有率
- 图表 2015-2019年Catalog 模拟半导体厂家市场占有率
- 图表 2015-2017年10大模拟半导体厂家排名
- 图表 2015-2019年MCU厂家排名

图表 2015-2019年DRAM产业CAPEX
图表 2015-2019年国际DRAM晶圆出货量
图表 2015-2019年Mobile DRAM市场份额
图表 2015-2017年国际12英寸晶圆产能
图表 2015-2019年主要Fab支出产品分布
图表 2015-2019年国际晶圆加载产能产品分布
图表 2015-2019年国际Foundry销售额排名
图表 2015-2019年国际MEMS厂家收入排名
图表 2015-2019年国际MEMS Foundry排名
图表 2015-2019年中国Foundry家销售额
图表 2015-2019年国际IC设计公司排名
图表 2015-2019年智能手机操作系统市场占有率
图表 2015-2019年国际晶圆设备投入规模
图表 2015-2019年国际半导体厂家资本支出规模
图表 2015-2019年国际WLP封装设备开支
图表 2015-2019年国际Die封装设备开支
图表 2015-2019年国际自动检测设备开支
图表 2015-2019年国际半导体材料市场地域分布
图表 2015-2019年国际半导体后段设备支出地域分布
图表 2015-2019年OSAT市场规模
图表 2015-2019年国际IC封装类型出货量分布
图表 2015-2019年国际OSAT产值地域分布
图表 2015-2019年中国台湾封测产业收入
图表 2015-2019年WLCSP封装市场规模
图表 2015-2019年WLCSP出货量下游应用分布
更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/tongxun/Q36189QOLG.html>